

MEXTAGE

第56期 中間 株主通信

2024年1月1日から2024年6月30日まで

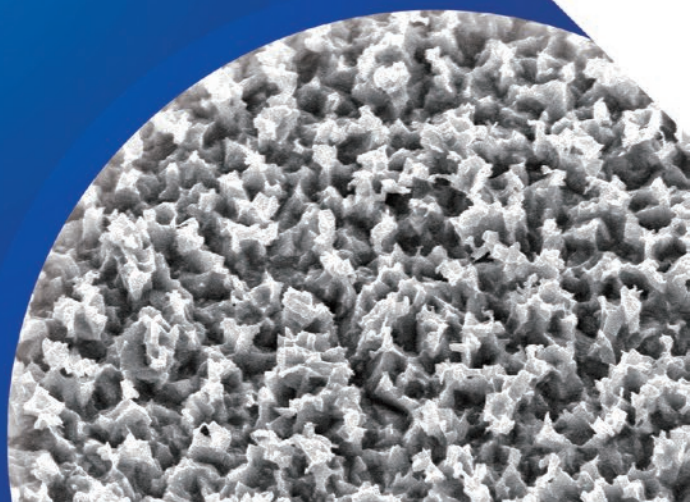
- P.1 2024年 中間期の業績振り返りと今後の事業戦略
- P.3 2024年 中間期の業績を教えてください
- P.4 TOPICS
- P.5 財務指標
- P.6 会社概要、株式の状況

社是

仕事を楽しむ

経営理念

わたしたちは「独創の技術」「信頼の品質」「万全のサービス」を信条に、自由に着想し、グローバルな事業活動を通して界面価値創造を実現することで豊かで潤いのある社会と環境づくりに貢献します。





社長に聞く!

2024 年 中間期の業績振り返りと 今後の事業戦略

当社の薬品プロセス採用に向けた 戦略的な取り組みを強化



■ 在庫一巡で、緩やかな回復基調で推移

当中間期におけるわが国経済は、円安によるコスト負担増加や個人消費の落ち込みなどで足踏み状態にあるものの、緩やかな回復基調にありました。海外経済においては、世界的な金融引き締めの影響や中国経済の先行き懸念、高い緊張状態にある地政学リスクの下で推移しました。

こうした状況下、半導体市場および関連するエレクトロニクス業界では、引き続き世界的に旺盛な生成AI*関連への投資が市場全体を牽引し、昨年まで投資が抑制傾向にあった従来型サーバーにおいても需要が復調に転じる動きがありました。また、電装化や自動運転への技術転換が進む車載関連は、概ね堅調に推移。在庫調整が一巡したと見られるパソコンやスマートフォンについても、緩やかな回復基調の中で推移しました。

これらの影響を受けて、当中間期の売上高については中間連結会計期間で過去最高になりました。利益面においても、薬品の生産数量の増加やグローバル生産戦略における生産効率改善等による利益貢献もあって、大幅な増益となりました。

■ 主力製品「CZシリーズ」が大きく増加

半導体を搭載するパッケージ基板向けに高いシェアを持つ超粗化系密着向上剤「CZシリーズ」は、関連する民生電子機器の在庫調整が一巡し、昨年まで生成AI分野が優先され、投資抑制にあった従来型サーバー向けの需要が復調に転じたほか、AIサーバー、通信関連の先端パッケージ基板向けが拡大基調にあることを受けて大きく増加しました。

■ 「EXE・SFシリーズ」は増加、 「V-Bondシリーズ」が堅調

エッチング剤「EXEシリーズ」は、TVを主としたディスプレイ搭載のCOF向けが在庫調整の一巡で需要回復に転じたことにより増加しました。ディスプレイ向け選択エッチング剤「SFシリーズ」も関連する電子機器の生産動向を受けて増加、多層電子基板の密着向上剤として使用される「V-Bondシリーズ」は、車載基板向けが堅調に推移しました。

代表取締役社長

前田和夫

北九州工場(仮称)の計画変更について

当社は新たな国内拠点、北九州工場建設の着工および稼働開始時期をそれぞれ2024年4月、2025年7月、総投資額を約40億円(土地取得費含む)としておりましたが、中長期戦略を見据えて、当社に関連する市場環境や技術動向により適した設計への見直しを行いました。着工時期を2024年8月、稼働開始時期を2025年10月、総投資額を約47億円に変更することとし、計画を進めています。

今後の事業戦略と注目するキーテクノロジー

IoT(モノのインターネット)・5G通信・AIの普及による情報量の増大に伴い、関連設備・電子機器で電気信号の高速化が進んでいますが、当社はこうした高速化対応機器向け薬品の開発・提供に力を入れています。また、次世代半導体では後工程のパッケージ技術がキーテクノロジーの一つとなっており、この技術領域に向けた薬品プロセスの研究開発に注力しています。

自動車分野では、電動化やADAS(先進運転支援システム)*の進展で、より多くの車載基板が搭載される一方、自動運転の本格普及に向けて最先端の半導体技術開発も進められています。

当社は、さらに当社の薬品プロセスを採用いただくため戦略的な取り組みを強化してまいります。

投資計画と配当政策

現在、多くのAI応用分野がまだ発展途上にあり、AIへの投資を実際の収益に結びつける「AIの収益化」が課題とされています。これから既存の製品やサービスにAI機能を統合し、AIを核としたサービスや事業モデルの開発が本格化すれば、AIへの再投資が活発化していきます。当社はこうしたトレンドをしっかりと見極め、適切な人財投資、設備投資を進めてまいります。

配当につきましては、従来どおり安定配当を基本に連結配当性向30%を目標においております。

株主の皆様へのメッセージ

近年、ITを活用した環境負荷低減につながる取り組み(グリーンIT)が注目されています。また、資源の効率的・循環的な利用を図る政策「サーキュラーエコノミー(循環経済)」が、わが国をはじめ先進国で推進されつつあります。当社はこうした環境分野にエネルギー効率に寄与する自社製品を提供するとともに、コア技術を応用したビジネス創出に取り組んでまいります。

今後の成長に向けては、マーケティングネットワークを拡充し、世界の多様な市場環境に根を下ろす活動に一層邁進し、当社が目指す企業像「真のグローバルカンパニー」に向けて持続的成長と企業価値の最大化を図ってまいります。株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

用語解説

生成AI(Generative AI)

画像・文章・音声・プログラムコードなど様々なコンテンツを生成できる人工知能

ADAS(先進運転支援システム: Advanced Driver-Assistance Systems)

先進技術を駆使してドライバーを支援する自動車の電子システム



詳細はホームページ掲載の決算短信をご覧ください。
www.mec-co.com/ir/library/



2024年 中間期のポイント

押さえておきたい2024年 中間期のポイントを2ポイントにまとめています。

1 過去最高の収益を更新

2 「CZシリーズ」はじめ全主要製品が増加



2024年 中間期の実績と通期業績予想

	2023年 12月期 中間期 2023年1月1日～ 2023年6月30日	2024年 12月期 中間期 2024年1月1日～ 2024年6月30日	増減	2024年 12月期 通期業績予想 2024年1月1日～ 2024年12月31日
売上高 (百万円)	6,198	8,882	43.3% 増	18,500
営業利益 (百万円)	838	2,362	181.8% 増	4,900
経常利益 (百万円)	1,003	2,641	163.3% 増	5,200
親会社株主に 帰属する中間 純利益(百万円)	1,076	1,890	75.7% 増	3,600 ^{*1}
1株当たり 中間純利益(円)	56.79	100.97		192.26 ^{*2}

*1 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)

*2 1株当たり当期純利益(円)

当社の主要薬品を紹介

密着向上剤

■ CZシリーズ

パッケージ基板向けに、銅樹脂間の密着性を高める用途で使用する薬品
(最終製品例: パソコン、スマートフォン、データセンター、サーバー等)

■ V-Bondシリーズ

多層基板向けに、銅樹脂間の密着性を高める用途で使用する薬品
(最終製品例: 車、スマートフォン等)

エッチング剤

■ EXEシリーズ

COF(Chip on Film) 基板向けに、不要な銅を溶かし微細配線を形成する用途で使用する薬品
(最終製品例: テレビ、パソコンのモニター等)

■ SFシリーズ

銅を選択的に溶かす用途で使用する薬品
(最終製品例: タブレットPC等)

業績推移および製品別・セグメント別販売動向について

Q 当中間期の事業環境と業績について教えてください

A 関連市場の復調で、大幅な増収増益となりました

当社グループの関係市場である電子基板・部品業界は、全般にエレクトロニクス業界の影響を受け、概ね回復基調のなかで推移しました。電子基板関連市場においては、車載関連が堅調に推移したほか、在庫調整が一巡したと見られるパソコンやスマートフォン等の民生電子機器向けは力強さには欠けるものの、緩やかながら回復基調で推移しました。

このような環境のもと、当社グループは「Phase 1中期経営計画（2022年度～2024年度）」を達成するため「創造と改革」を指針に事業活動に取り組み、高密度電子基板向け製品の開発・販売に注力しました。半導体を搭載するパッケージ基板向けに高いシェアを持つ超粗化系密着向上剤「CZシリーズ」は、関連する電子機器において在庫調整が一巡し、当社製品の需要が回復基調にあることや先端パッケージ向けの需要も拡大基調にあることを受け、大きく増加しました。ディスプレイ向け「EXEシリーズ」も関連する電子機器の在庫調整一巡により、関連する当社製品需要に回復が見られ増加し、ディスプレイ向け「SFシリーズ」は関連する電子機器の生産動向を受けて増加、多層電子基板向け密着向上剤「V-Bondシリーズ」は車載基板向けが堅調に推移しました。

その結果、当中間期の売上高は88億82百万円（前年同期比43.3%増）、営業利益は23億62百万円（同181.8%増）、売上高営業利益率は26.6%（同13.1ポイント増）、経常利益は26億41百万円（同163.3%増）、親会社株主に帰属する中間純利益は18億90百万円（同75.7%増）となりました。

Q 製品別の販売状況を教えてください

A 売上は全般に増加

「CZシリーズ」の売上高は54億7百万円（前年同期比45.8%増）、薬品売上高に占める割合は64.5%（同3.5ポイント増）となりました。「EXEシリーズ」は7億50百万円（同37.8%増）、「SFシリーズ」は3億23百万円（同32.9%増）、「V-Bondシリーズ」は4億1百万円（同11.4%増）となりました。

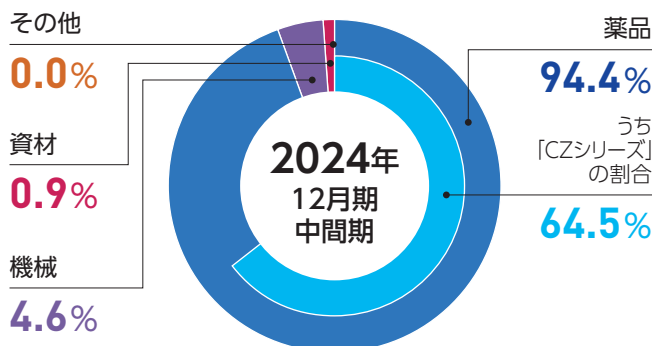
Q 地域別の販売動向はどうでしたか？

A 国内は先端向けが堅調、海外は全般に回復基調

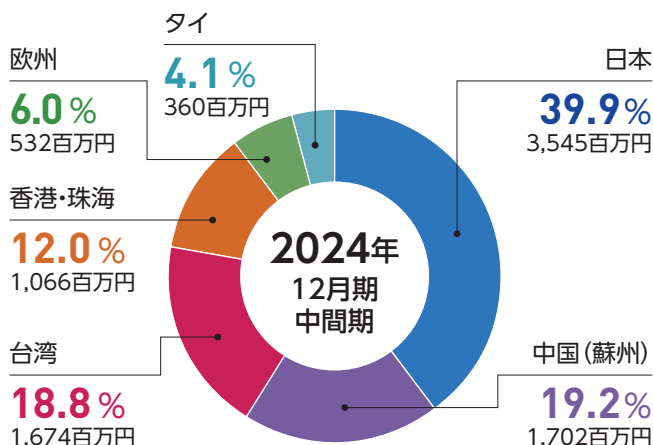
地域別売上高（連結）における海外売上高比率は61.4%（前年

同期比1.1ポイント減）となりました。日本では、生成AI向け等先端パッケージ基板向け製品の需要が堅調に推移したほか、パソコン関連製品の需要も回復の兆しが見られ、従来型サーバーにおいても需要が復調に転じました。日本代理店経由で販売している韓国向けにおいては、メモリー向けパッケージ基板は回復途上であり、当社製品の需要に力強さは見られませんでした。台湾では従来型サーバーの投資回復等でパッケージ基板の需要が復調しつつありました。香港（香港・珠海）は、スマートフォンや車載関連製品の需要が緩やかな回復基調にありました。中国（蘇州）は、サーバーやスマートフォン関連製品の需要に回復の兆しが見られました。欧州は顧客により需給動向に濃淡が見られましたが増収、タイでは主に多層基板向け製品の需要に回復傾向が見られました。

売上高に占める品目別割合（%）



地域セグメント別売上高比率（%）／売上高（百万円）



* 比率は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。

競争力の源泉「独創の技術」

デジタル技術の進化は、私たちの社会や経済に大きな変革をもたらしました。その進展を支えてきた中心は、パソコンやスマートフォン等の電子機器でしたが、これからはデータの活用、特にAIに牽引され半導体は進化し、併せてデータ処理、通信の高速化・高度化が進み本格的なデジタル社会が到来しようとしています。

これまで半導体の性能向上を支えてきたのは、主に半導体製造「前工程」でしたが、近年は「前工程」だけで性能を高めることが難しくなり、替わって複数チップの積層などを行う

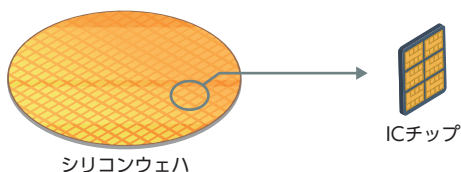
「先端パッケージング技術」の開発が進む「後工程」が注目されています。

当社主力製品「CZシリーズ」は、「後工程」に必要とされる部材である半導体を搭載するパッケージ基板製造の一部工程で広く採用され、世界で独占的シェアを有する製品です。当社グループは、創業来「独創の技術」でお客様の課題解決に貢献し、エレクトロニクス業界の発展を支えてきました。今後も持続可能な社会に向けて技術開発に一層注力し、事業機会の拡大を目指してまいります。

従来の半導体製造

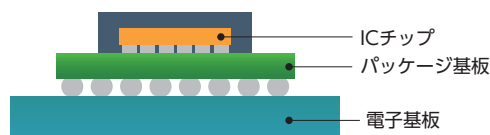
前工程

シリコンウェハ上に微細な回路を形成



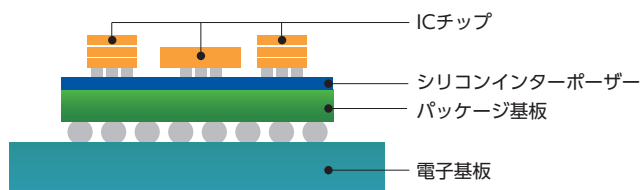
後工程

半導体パッケージを組み立て、電子基板に搭載



最新(生成AI)パッケージ基板の一例

1つのパッケージ基板に複数の半導体チップを搭載することによりパッケージ基板のサイズが拡大、多層化しており、当社薬品使用量の増加につながっています。



施設見学会のご案内 2024年11月28日(木)開催



株主さまに当社へのご理解をより深めていただくことを目的に、下記概要のとおり、当社本社・尼崎事業所の見学会を開催いたします。当日は会社説明を行った後、メックの“ものづくりの現場”をご見学いただきます。

見学会への参加をご希望の株主さまは、同封の応募はがきに必要事項をご記入の上、ご応募ください。

皆さまの安全確保のため、ご応募多数の場合は抽選となります。なお、ご当選者の発表は、ご当選のお知らせの発送(10月25日発送予定)をもって代えさせていただきます。

見学会概要

開催日時: 2024年11月28日(木曜日)

13時30分～(終了は16時30分の予定)

集合場所: メック株式会社 本社・尼崎事業所

兵庫県尼崎市杭瀬南新町三丁目4番1号

募集人数: 30名様

対象: 当社株式を100株以上保有の株主様(2024年6月末現在)

応募締切: 2024年10月18日(金曜日)当日消印有効

前回の様子 <https://www.mec-co.com/ir/briefing/>

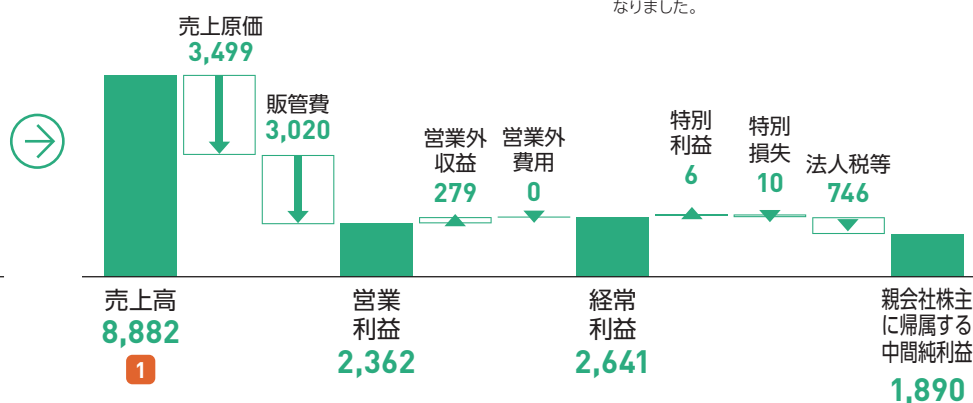


連結損益計算書の概要 (百万円)

2023年12月期 中間期
 (2023年1月1日～2023年6月30日)



2024年12月期 中間期
 (2024年1月1日～2024年6月30日)

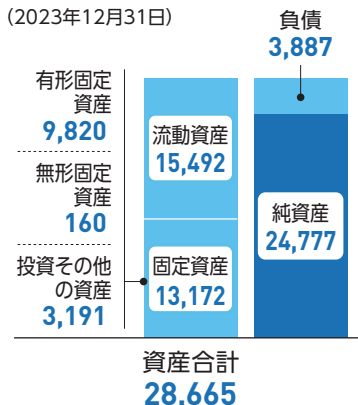


1 売上高

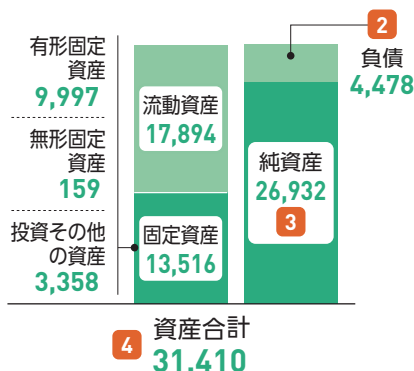
薬品売上高は83億84百万円、機械売上高は411百万円、資材売上高は81百万円、その他売上高は4百万円となりました。

連結貸借対照表の概要 (百万円)

前期末
 (2023年12月31日)

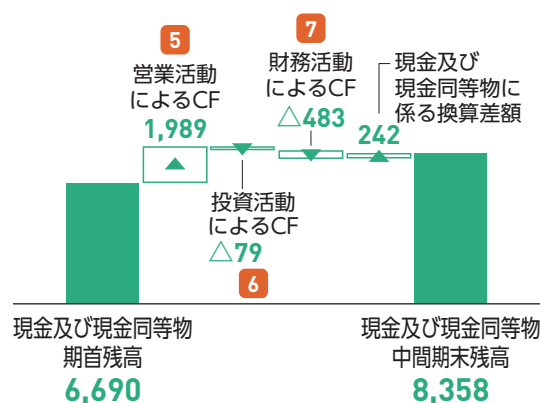


2024年12月期 中間期
 (2024年6月30日)



連結キャッシュ・フロー計算書の概要 (百万円)

2024年12月期 中間期
 (2024年1月1日～2024年6月30日)



2 負債

負債は、支払債務や未払法人税等の増加等により、44億78百万円となりました。

3 純資産

純資産は、利益剰余金の増加や円安による為替換算調整勘定の増加等により、269億32百万円となりました。

4 資産合計

資産は、現金及び預金や売上債権の増加等により、314億10百万円となりました。

5 営業活動によるCF

営業活動の結果得られた資金は19億89百万円。これは主に税金等調整前中間純利益が26億37百万円、減価償却費が3億91百万円、法人税等の支払額が2億84百万円あったこと等によるもの。

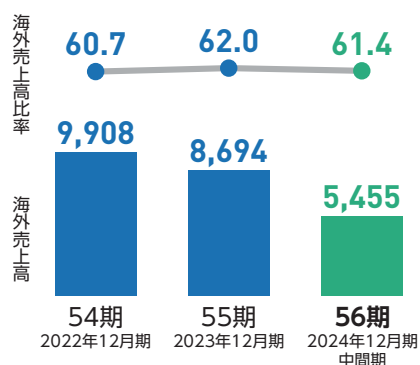
6 投資活動によるCF

投資活動の結果使用した資金は79百万円。これは主に定期預金の払戻による収入が純額で6億5百万円、有形固定資産の取得による支出が5億8百万円あったこと等によるもの。

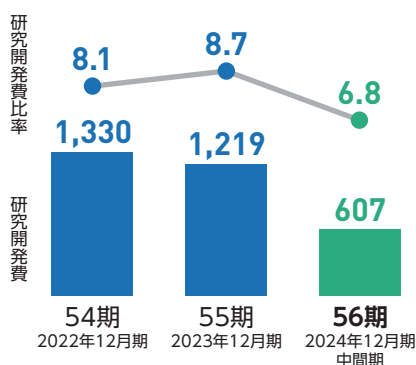
7 財務活動によるCF

財務活動の結果使用した資金は4億83百万円。これは主に配当金の支払いが4億72百万円あったこと等によるもの。

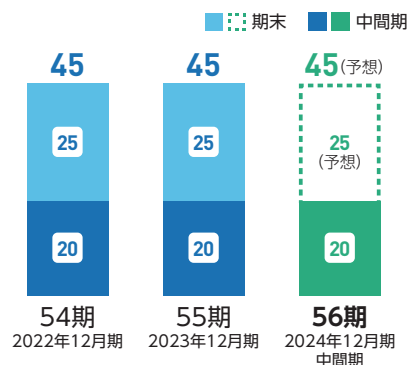
海外売上高(百万円)／比率(%)



研究開発費(百万円)／比率(%)



1株当たりの配当金(円)



会社概要

■ 2024年6月30日現在



会社概要

商号 メック株式会社
本社事務所所在地 兵庫県尼崎市杭瀬南新町三丁目4番1号
設立年月日 1969年(昭和44年)5月1日
資本金 594,142,400円
事業内容 電子基板・部品製造用薬品の製造販売
および機械装置、各種資材の販売

取締役および執行役員

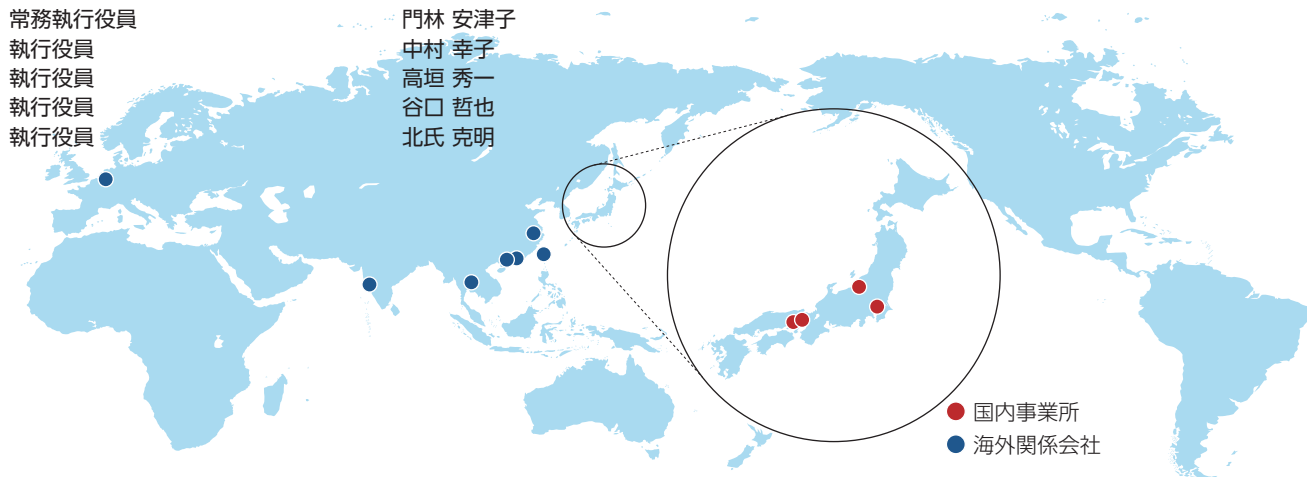
代表取締役社長 前田 和夫
取締役常務執行役員 中川 登志子
取締役常務執行役員 住友 貞光
取締役(社外) 北條 俊彦
取締役 監査等委員会委員長(社外) 高尾 光俊
取締役 監査等委員(社外) 橋本 薫
取締役 監査等委員(社外) 宮下 英二
常務執行役員 門林 安津子
執行役員 中村 幸子
執行役員 高垣 秀一
執行役員 谷口 哲也
執行役員 北氏 克明

国内事業所

本社・尼崎事業所
本社・東初島事業所
東京営業所
長岡工場

海外拠点

MEC TAIWAN COMPANY LTD.
MEC EUROPE NV.
MEC (HONG KONG) LTD.
MEC FINE CHEMICAL (ZHUHAI) LTD.
MEC CHINA SPECIALTY PRODUCTS (SUZHOU) CO., LTD.
MEC SPECIALTY CHEMICAL (THAILAND) CO., LTD.
MEC INDIA SPECIALTY CHEMICALS PRIVATE LTD.



株式の状況

■ 2024年6月30日現在

株主状況

発行済株式総数 20,071,093 株
株主数 4,289 名

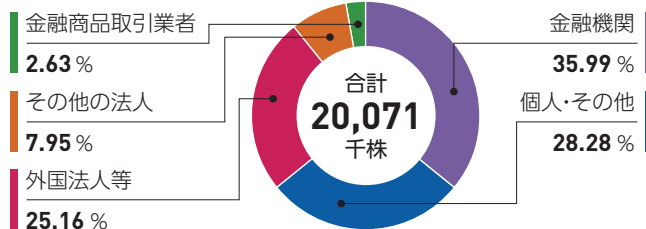
大株主の状況

株主名	当社への出資状況	
	所有株数(千株)	持株比率(%)
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	2,946	15.60
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	2,785	14.74
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	1,262	6.68
株式会社マエダホールディングス	1,199	6.34
前田和夫	726	3.84
前田耕作	555	2.93
メック取引先持株会	547	2.89
野村信託銀行株式会社(投信口)	495	2.62
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	416	2.20
住友生命保険相互会社	345	1.82

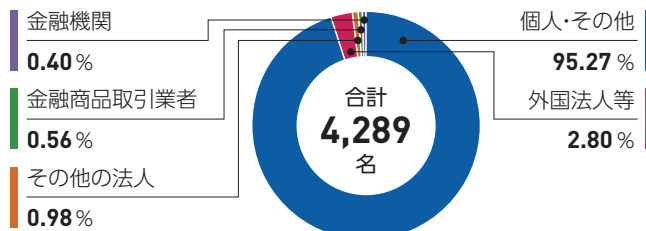
※当社は自己株式を1,181千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
※持株比率は、自己株式を除く発行済株式の総数に対する比率です。

株式分布状況

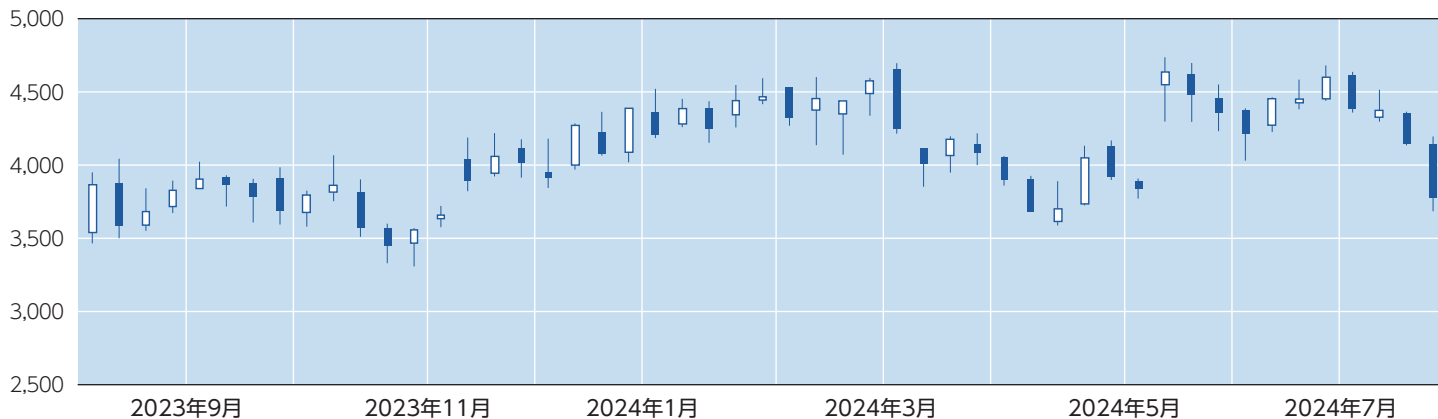
所有者別所有株式数



所有者別株主数



※「個人・その他」には自己株式1,181千株を含んでおります。
※比率は小数点以下第3位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。



株主メモ

事業年度	毎年1月1日から12月31日まで
期末配当金 受領株主確定日	毎年12月31日
中間配当金 受領株主確定日	毎年6月30日
定時株主総会	毎年3月
単元株式数	100株
株主名簿管理人 および特別口座 の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
株式名簿管理人 事務取扱場所	大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先	三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
電話照会先※	TEL. 0120-782-031 (通話料無料) 受付時間 9:00～17:00 (土日休日を除く)
インターネット ホームページURL	www.smtb.jp/personal/procedure/agency/
上場証券取引所	東京証券取引所プライム市場
証券コード	4971
公告の方法	電子公告により行う。 公告掲載URL www.mec-co.com/ir/denshi/ (ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。)

ニュースメール配信サービスのご案内

当社では、ホームページにニュースリリースや新しいコンテンツが掲載された際に、ご登録者の皆様にそのタイトルとURLを電子メールにてお知らせするサービス(ニュースメール配信サービス)を行っています。
ご希望の株主様には、こちらのサービスの送信先メールアドレス(携帯電話のメールアドレス不可)を、当社ホームページまたは、RIMSNET (rims.tr.mufig.jp/)から、簡単にご登録いただけます(無料)。

アンケートのお願い

当社では、株主の皆様とのよりよいコミュニケーションを目指し、今後も業績情報の開示の充実に努めていきたいと考えています。
つきましては、この株主通信に対するご意見、ご感想をお聞かせいただきたくアンケートにご協力をお願いいたします。
※ご提供いただきました情報は、本アンケートの集計の目的以外に使用することはありません。

ホームページのご紹介

当社のホームページでは企業情報、サステナビリティ情報、製品情報、投資家情報、技術情報等の各種情報を掲載しています。
サステナビリティ報告書2024を発行しました。
ぜひQRコードよりご覧ください。



株式に関する住所変更等のお手続きについてのご照会

- 証券会社の口座をご利用の株主様は、三井住友信託銀行株式会社ではお手続きができませんので、取引証券会社へご照会ください。
- 証券会社の口座をご利用でない株主様は、上記電話照会先※までご連絡ください。

株主優待情報

保有株式数	優待内容
1,000株未満	QUOカード 1,000円分
1,000株以上	QUOカード 2,000円分

*毎年12月31日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式100株(1単元)以上保有の株主様を対象といたします。



メック株式会社

本社事務所／〒660-0822 兵庫県尼崎市杭瀬南新町三丁目4番1号
TEL. 06-6401-8160 FAX. 06-6401-8165

URL www.mec-co.com/

